

# 积层贴片陶瓷片式电容器

C2012X5R0J156M085AB

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 交货型号 | C2012X5R0J156MT****      |
| 用途   | 一般等级                     |
| 特点   | <b>General</b> 一般 (~75V) |
| 系列   | C2012 [EIA 0805]         |
| 状态   | 量产体制(新设计非推荐)             |



## 尺寸

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 长度(L)       | 2.00mm ±0.20mm                      |
| 宽度(W)       | 1.25mm ±0.20mm                      |
| 厚度(T)       | 0.85mm ±0.15mm                      |
| 端子宽度(B)     | 0.20mm Min.                         |
| 端子间隔(G)     | 0.50mm Min.                         |
| 推荐焊盘布局 (PA) | 1.00mm to 1.30mm (Flow Soldering)   |
|             | 0.90mm to 1.20mm (Reflow Soldering) |
| 推荐焊盘布局 (PB) | 1.00mm to 1.20mm (Flow Soldering)   |
|             | 0.70mm to 0.90mm (Reflow Soldering) |
| 推荐焊盘布局 (PC) | 0.80mm to 1.10mm (Flow Soldering)   |
|             | 0.90mm to 1.20mm (Reflow Soldering) |

## 电气特性

|             |            |
|-------------|------------|
| 电容          | 15 μF ±20% |
| 额定电压        | 6.3VDC     |
| 温度特性        | X5R (±15%) |
| 耗散因数 (Max.) | 10%        |
| 绝缘电阻 (Min.) | 6MΩ        |

## 其他

|          |               |
|----------|---------------|
| 焊接方法     | 流体            |
|          | 回流            |
| AEC-Q200 | NO            |
| 包装形式     | 纸编带 (180mm卷筒) |
| 包装个数     | 4000pcs       |

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

## Associated Images

